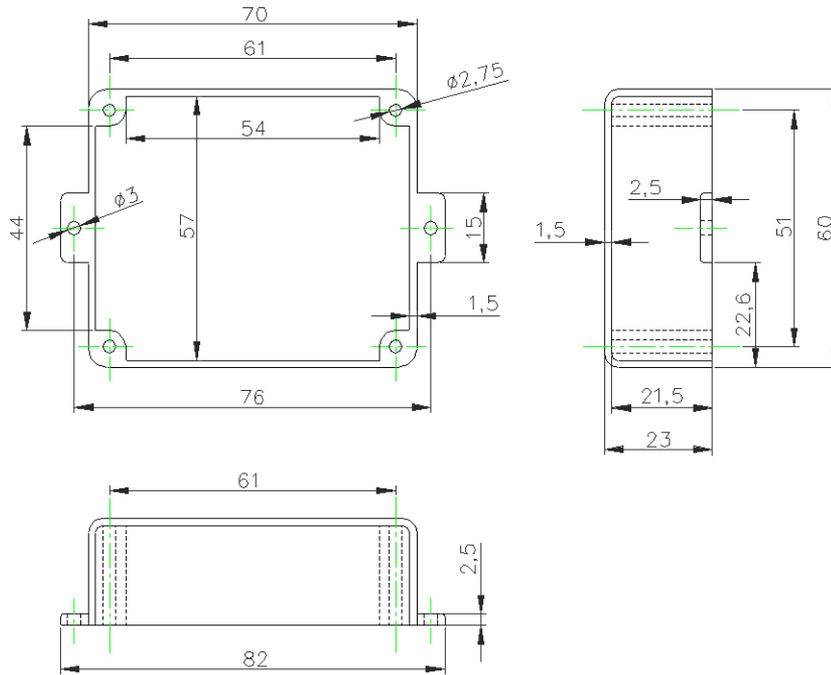


Modul- Gehäuseoberteil



Modul- Gehäuseoberteil schwarz.
 Modul- Gehäuseoberteil mit offenem Boden.
 Gehäuse wird nach Einsetzen und Anschliessen
 der Platine mit Giessharz verschlossen.

[Verwendungsbereich] G060 Modul-Gehäuse mit Befestigungslaschen		[Zul. Abw.]	[Oberfl.]	Maßstab 1:1	[Gewicht]
				Werkstoff Halbzeug Thermoplast [Rohteil-Nr] oder Gesenk-Nr]	
			Datum	Name	MODUL-GEHÄUSE
			Bearb. 22.04.05	M.SIMON	
			Gepr.		
			Norm		
					G060
Zust.	Änderung	Datum	Name	KEMO-Electronic GmbH	Ersatz für:
					Ersatz durch:
					Blatt 1 von 1 Blätter